Lötdraht Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,75 mm, C3+, bleifrei, 500g



Dieser Lötdraht von Tamura Elsold wurde für professionelle Anwendungen in der Elektronikfertigung, im Servicebereich sowie für anspruchsvolle Reparaturlötungen entwickelt. Die bleifreie Legierung Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307) bietet eine ausgezeichnete Lötbarkeit, hohe Zuverlässigkeit und stabile elektrische Verbindungen. Dank des Durchmessers von 0,75 mm eignet sich der Lötdraht besonders für präzise Handlötarbeiten und feine elektronische Baugruppen.

Das halogenfreie Flussmittel C3+ sorgt für eine optimale Benetzung der Lötstellen und unterstützt saubere, reproduzierbare Lötergebnisse. Die Flussmittelrückstände sind als No-Clean-Rückstände ausgelegt, wodurch zusätzlicher Reinigungsaufwand häufig entfällt. Die mikrolegierte MA-S-Technologie erhöht zudem die Oxidationsbeständigkeit und verbessert die Prozesssicherheit bei längeren Lötarbeiten.

- Legierung: Sn99Ag0,3Cu0,7 (SAC0307)
- Drahtdurchmesser: 0,75 mm
- Flussmitteltyp: C3+

- Flussmittelanteil: 3,5 %
- Flussmittelklasse: ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Halogenfreies Flussmittel
- Bleifreie Ausführung
- Mikrolegierung MA-S für erhöhte Oxidationsbeständigkeit
- Spulengewicht: 500 g

Artikel-Nr.	**WL93259**
Modell	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	RÖLOT6138
GPSR Herstellerdaten	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Detail Inhaltseinheit	500 g
Flussmittelklasse	1.1.3, F-SW32, ROL0
Legierung	Sn99Ag0,3Cu0,7
Flussmitteltyp	C3+
Flussmittelanteil	3,5 %
Klassifizierung	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Drahtdurchmesser	0,75 mm
Legierung	Sn99Ag0,3Cu0,7
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei
ESD gerecht	nein